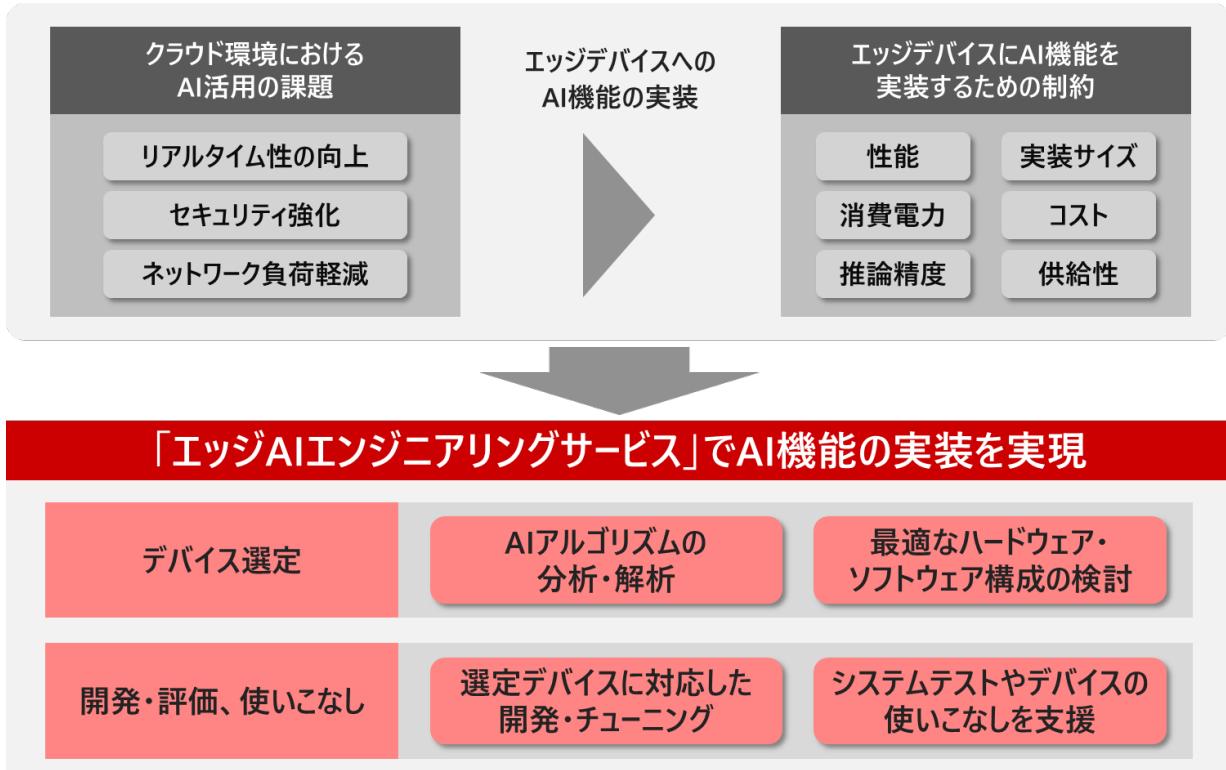


2025年12月17日  
株式会社日立情報通信エンジニアリング

## エッジデバイスへのAI機能の実装最適化を支援する「エッジAIエンジニアリングサービス」を販売開始

お客様のニーズと利用シーンに応じた最適なデバイス選定および開発・評価、使いこなしをサポート



「エッジAIエンジニアリングサービス」の概要

株式会社日立情報通信エンジニアリング(以下、当社)は、学習済みAIモデルを基に、エッジAI<sup>\*1</sup>に最適なデバイス選定から開発・評価、使いこなしまで一貫してサポートする「エッジAIエンジニアリングサービス」を、12月17日から販売開始します。

本サービスにより、リアルタイム性の向上やセキュリティ強化、ネットワーク負荷軽減など、クラウド環境でのAI活用における課題解決に向けたエッジデバイスへのAI機能の実装において、さまざまなニーズや利用シーンに合わせた実装最適化を支援します。

また、当社が持つ、多様な分野の受託開発で培った豊富なノウハウをメニュー化した「メニューベースエンジニアリングサービス」<sup>\*2</sup>の新ラインアップとして、エッジAIの実装におけるお客様の要望に合わせた高信頼で最適な支援をスピーディーに提供します。

\*1 エッジAI：エッジデバイス(端末機器)に直接搭載したAI

\*2 メニューベースエンジニアリングサービス：ハードウェア・ソフトウェアの開発・設計における、お客様の共通課題の解決策をメニュー化したサービス

## ■背景

現在、AIは多くの場合、クラウド環境で利用されていますが、「通信遅延によるリアルタイム性の不足」「セキュリティとプライバシーの懸念」「通信コストと帯域の制約」などのさまざまな課題に直面し、エッジへの移行の必要性が増しています。

AIのエッジ化は、リアルタイム性の向上やセキュリティ強化、ネットワーク・クラウドへの負荷軽減といった多くの効果が期待されていますが、その一方で、エッジへのAI機能実装には、さまざまな選択肢があり、その中から最適なものを選択することが課題となっています。

そこで当社は、エッジデバイスへのAI機能実装の最適化を支援する「エッジAIエンジニアリングサービス」を提供します。

## ■「エッジAIエンジニアリングサービス」の内容

エッジデバイスへのAI機能の実装最適化を実現するため、以下の支援を行います。

### (1)デバイス選定

- ・「AIアルゴリズムの分析・解析」：性能・電力、AI(推論)精度、コストなどの事前検証
- ・「最適なハードウェア・ソフトウェア構成の検討」：AIモデルに最適なハードウェア選定、ソフトウェアアルゴリズム最適化

### (2)開発、評価、使いこなし

- ・選定デバイスに対応した開発・チューニング
- ・システムテストやデバイスの使いこなしを支援

## 【対応例】

- ・AI機能実装制約条件の事前検証による最適なデバイス選定
- ・AIモデル解析・変換・評価のイテレーション(繰り返し)による最適化(アルゴリズム解析・等価性検証・構造化など)
- ・論理設計のノウハウを生かした専用チップのパイプライン化やチップ分割など、サイズ・コストと性能の両立検討・検証

## ■本サービスの適用例(ユースケース)

製造業・工場、ヘルスケア・医療など、幅広い分野・業種でのエッジAI機能実装の最適化を支援します。

1	現場作業支援	現場保守・修理作業の効率化、平準化(熟練者のスキル継承)、作業品質向上、安全確保
2	装置稼働支援	各種センサーデータなどを用いた装置の状態識別により、障害や品質低下を防止
3	自動運転支援	車載カメラシステムなどによるデータをリアルタイムで分析・判断し、ドライバーの自動運転を支援

## ■今後の展開

Physical AI領域において、エッジAIエンジニアリングを活用したソリューションメニューを体系化し、お客さまへの新たな提供価値の創出に取り組んでまいります。

## ■「エッジAIエンジニアリングサービス」の概要

項目	サービス内容
デバイス選定	「AIアルゴリズムの分析・解析」　性能・電力、AI(推論)精度、コストなどの事前検証
	「最適なハードウェア・ソフトウェア構成の検討」　AIモデルに最適なハードウェア選定と、ソフトウェアアルゴリズム最適化
開発・評価、デバイス使いこなし	選定デバイスに対応した開発・チューニング
	システムテストやデバイスの使いこなしを支援

## ■ハードウェア・ソフトウェア検討における主なデバイス、コンパイラ・開発ツール群

項目	主な対応可能な種類 * その他についてはご相談ください
デバイス	CPU、GPU、AI チップ、FPGA、ASIC
コンパイラ	LLVM、NVCC、HIPCC、OpenCL-JIT
抽象化層	ONNX、CUDA、ROCm、SYCL、OpenCL

## ■関連ページ

- ・「エッジ AI エンジニアリングサービス」について

[https://www.hitachi-ite.co.jp/lineup/engineering/service/edgeai\\_eng/index.html](https://www.hitachi-ite.co.jp/lineup/engineering/service/edgeai_eng/index.html)

- ・「メニューベースエンジニアリングサービス」について

<https://www.hitachi-ite.co.jp/lineup/engineering/service/index.html>

## ■商標に関する表示

記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

NVCC、CUDA は、米国およびその他の国における NVIDIA Corporation の商標または登録商標です。

ONNX® は、LFProjects, LLC の商標または登録商標です。

ROCM™ は Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標です。

SYCL™ は The Khronos® Group Inc. の商標です。

OpenCL™ は、Apple Inc. の商標であり、Khronos による使用許諾のもとに使用しています。

## ■日立情報通信エンジニアリングについて

エンジニアリング × ネットワーキングの強みを融合させ、獲得したケイパビリティを生かすとともに、OT × DX、さらに AI を活用し、受託開発・エンジニアリングサービスを提供、パートナーとともにデジタル社会の発展に貢献します。詳しくは、[日立情報通信エンジニアリング](#)のウェブサイトをご覧ください。

## お問い合わせ先

株式会社日立情報通信エンジニアリング

<https://www.hitachi-ite.co.jp/inquiry/newsrelease.html>

---

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

---